

●2008 年度通期決算説明会（IR）質疑応答議事録

日時 : 2009 年 4 月 30 日（木）17:30~18:45
場所 : 富士通汐留本社 24 階大会議室
説明者 : 代表取締役社長 野副 州旦
CFO 経営執行役上席常務 加藤 和彦

質問者 A

Q: 国内の 09 年度のテクノロジー・ソリューションの分野別の前年比売上予測を教えてください。

A: (加藤)

国内の産業・流通は 08 年度は前年比で若干の減収でしたが、09 年度は更に売上が 10%程度落ちて前年比 89%となり、厳しいとみています。テレコムは 08 年度にお客様の投資がピークを迎えたため前年度より増収となりましたが、09 年度は前年比 97%の減収となる見込みです。金融は 08 年度はクレジット系の特需がありましたので、07 年度比増収でした。それに対し、09 年度は前年比 95%の減収とみておりますが、テレコム・金融ともに 08 年度に高水準の売上に達しておりそのレベルが続くとみています。公共は 08 年度は増収、09 年度も前年比 101%で増収のイメージです。地域は 08 年度は第 4 四半期に入って落ち込み減収となりましたが、09 年度は前年比 100%、前年並みとみています。このように国内の IT 市場は全般的に厳しい状況ですが、売上は業種別にはまだ模様が出ています。グローバル市場では、英国の売上が伸びないとみています。やはり国の予算の引き締めや、値下げ要求が強くなり、伸び悩むところが出てくるでしょう。北米も全般に市場が厳しいとみています。08 年度は北米の子会社 3 社を統合したこともあり非常に苦戦しましたが、第 4 四半期からその効果により、大型の商談が獲得されました。このように、市場が悪い中でも 09 年度のサービスは、なんとか 08 年度よりも売상을伸ばせそうです。

Q: 減価償却費が 08 年度 2,239 億円から 09 年度の 1,800 億円に減っていますが、そのうち半導体と HDD の減損損失による償却費削減効果はそれぞれどのくらいですか？また、半導体は 45nm 以降の製品はこの 4 月以降 TSMC に委託するのでしょうか？また、三重の第 2 棟の設備の売却は視野に入れているのでしょうか？

A: (加藤)

HDD は、減損損失の効果よりも事業譲渡によりビジネスが第 2 四半期からなくなる効果が一番大きく、営業利益が 200 億円好転する計画です。デバイスでは三重の第 2 棟について 500 億円近い減損損失を計上しました。これにより、09 年に 150 億円弱の償却負担が減る予定です。さらに、基盤ラインの再編効果が 100 億円程度、下期に段階的に出てきます。また、減価償却費の圧縮だけでなく、TSMC との共同開発で先端のプロセスの開発費用の圧縮、さらに低操業による人件費の圧縮を図れる予定です。全体で 600 億円程度の経費が改善できるとみています。一方、減収で 200 億円程度利益が悪化する見込みです。

TSMC に設備を売却するという話は出ていません。45nm までは自社ファブで製造し、

40nm 以降は TSMC のファブを借りて一緒に製造をしようというのが今回のメッセージです。

(野副)

仮に減収であっても増益を目指すための構造改革を 08 年度中におこなっています。それらの効果は 09 年度に出てきますので、08 年度に対して利益の上積みが出来ると思っています。ただ、08 年度下期に作り上げた数字に対して、09 年度上期の経済環境がどう動くかを見極めているところで、慎重に検証したいと考えています。

半導体は 09 年度に黒字化を達成できないという前提で、09 年度中にファブライトに近いビジネスモデルに近づける必要があると判断しました。その最初のステップとして、40nm 世代の製造は TSMC に委託するという今回の内容で合意しましたが、それ以降の先端をどうするかについてはまだ協議中です。いずれにしても、09 年度はコスト体質を極めて軽くして、10 年度以降に景気が回復したときにすばやく好調基調に乗っていただけるような体質強化を仕上げるための取り組みをおこなっていきます。

Q: 現時点で 09 年度下期の不透明感はどの程度リスクとして織り込まれていますか？

A: (加藤) 売上ベースはかなり保守的にみています。計画を作る上では、売上を伸ばす前提の議論はしておらず、現場の生の声を反映させています。

質問者 B

Q: 09 年度上期と下期のセグメント別の営業利益について教えてください。

A: (加藤)

テクノロジーソリューションは上期 250 億円の黒字、下期 1500 億円の黒字と予想しています。そのうち、サービスは上期 350 億円の黒字、下期に 1300 億円の黒字を予想しています。システムプラットフォームは上期 100 億円の赤字、下期は 200 億円の黒字を予想しています。

ユビキタスプロダクトソリューションは第 1 四半期まで当社の連結セグメントにある HDD の赤字が 100 億円ありますが、セグメントの通期では黒字を出すことができる予定です。デバイスソリューションは上期は赤字、下期はゼロラインを少し超える程度の黒字を確保します。

Q: 半導体工場の稼働率はどうなっていますか。また思い切った減損損失を計上していますが、他社と提携しやすくするためと考えてよいでしょうか。

A: (加藤)

第 4 四半期の稼働率は基盤が約 30%、先端が約 40%程度になりました。第 1 四半期は厳しい状況が続くと予想されますが、在庫調整が進んだことや、基盤ラインの再編に伴う作り溜めにより、先端は 70%程度、基盤は 50%程度まで回復すると見込んでいます。

(野副)

他社と当社では半導体事業のビジネスモデルのあり方が違うと考えております。08 年度特別損失を出すことで、09 年度は事業の健全性が向上し、TSMC との協調等の中でファブライト化を進め、単独で利益を出せる体質を目指します。今後どのような形で生

きていけるか、どこをスリム化するか、力を入れる分野はどこかを 09 年度に見極めたいと考えております。

Q: 富士通テクノロジソリューションズ (FTS) のインフラサービスやユビキタスプロダクトの売上規模はどのくらいですか。

A: (加藤)

FTS のインフラサービスは、年間で売上 3000 億円弱、ユビキタスプロダクトで PC の売上 2400 億円弱となります。

Q: 役員が大幅に入れ替わるようにみえますが、社長のお考えをお聞かせください。

A: (野副)

テクノロジーソリューションの強化のための組織編制を考えています。ビジネスグループ (BG) のマネジメントを常務クラス 1 人に集中させ、その下にどの程度ビジネスユニット (BU) をつくるか見直し、BU 長に担当するビジネスの責任を集中化させたいと考えています。詳しくは中期計画発表の席でお話できればと思っています。

Q: FTS を連結化することによるインフラサービスの利益影響について教えてください。

A: (加藤)

09 年度の FTS 暖簾償却 150 億円のうち、インフラサービスに約 100 億円が入っています。FTS の連結子会社化で暖簾代を除く営業利益が 100 億円弱の黒字ですので、インフラサービスへの利益影響は暖簾代との相殺でイーブンとなります。

Q: 半導体全体の今後の生産能力についてどうなりますか。

A: (加藤)

現在の生産能力は過大です。基盤はラインの統廃合を行いますので、2010 年度後半からは逆に逼迫感がでてきます。

質問者 C

Q: 2009 年度のサービスの業績予想は、事業再編影響等の特殊要因を除くと、売上高は前年比 100 億円の増収、営業利益は 150 億円の増益とのことですが、他の独立系 IT サービス企業の市場の見方に比べ強気の印象を受けます。何が要因でしょうか。

A: (加藤)

2008 年度第 4 四半期から本格的な経費削減を推進し、その効果を着実に出すことができました。2009 年度は第 1 四半期からこの経費削減効果を出していくことで、さらなる利益改善を図ることができるものと考えています。

加えて、2008 年度はアウトソーシングを中心とした国内のインフラサービスが堅調に推移しましたが、この傾向を 2009 年度も継続できると見えています。

(野副)

加藤の説明に補足すると、国内では以前から育成を続けてきたフィールド・イノベータの実戦投入を予定しています。また、SE の回転率が上がってきているため、これらによる収益改善効果も見込んでいます。

Q. LSI について、40nm 世代製品の製造を台湾の TSMC に委託するとの発表がありました
が、今後の他社との事業統合や業務提携の可能性はなくなったということでしょうか。
それとも、富士通にとって理想的な相手が現れれば、今後も積極的に検討していくの
でしょうか。

A. (野副)

将来的な他社との事業統合等の可能性を否定するものではなく、理想的と思われる相
手がいれば検討します。しかし、現在は半導体業界全体が非常に厳しい市場環境下
にあり、そのような中で実効性の高い事業統合や業務提携を実現するのは、そう簡単
ではありません。また、そのための交渉を進めるためには、富士通自身が交渉に耐え
得る体制となっていることが先決です。今回の TSMC との発表は富士通自身の体制強化
に向けた取り組みとご理解ください。

先日、FTS を完全子会社化し、IA サーバの 2010 年度販売台数 50 万台を目標とするこ
とを明言したところ、世界中の企業から今まで以上に踏み込んだ枠組みでの提携をし
たいといった申し出を多数いただきました。LSI 関連の交渉よりも、今はこのようなテ
クノロジーソリューションのさらなる成長に繋がるような交渉を優先すべきだと考え
ています。

Q. 国際財務報告基準(IFRS)への移行時期は、いつを予定していますか。

A. (加藤)

いつでも移行できる準備は整えています。具体的な移行時期は未定です。IFRS に移
行すると暖簾代の償却が不要になるため、営業利益に対してはポジティブな影響があ
ります。一方で、IFRS では年金債務を計上しなければならなくなるため、自己資本が
毀損して見えるようになります。格付機関からは、格付にはこれらの影響をすでに織
り込んでいるとのコメントをいただいているため、いつでも移行はできると考えてい
ます。

質問者 D

Q: 2月時点の見込みより良かったとのことですが、サービスの利益は3Q決算時の見込み
に対して若干未達に見えます。国内のサービスビジネスが良かったということですか。
また、09年度のソリューション/SIはどれくらい減収減益で、アウトソーシングがどれ
くらい増収増益なのかを確認させてください。

A: (加藤)

ソリューション/SI の国内売上は3桁の減収を予想しております。利益面では、統合・
再編した北米子会社が今年3月に大型商談を受注する等、北米ビジネスの成長が期待
でき、09年度は増益を予想しております。

インフラサービスは、09年度も堅調に売上を伸ばす計画ですが、利益面では国内を中
心にアウトソーシングでの値下げ影響を考慮し、前年並みと予想しております。

(野副)

08年度は海外ビジネスのマイナス分を国内ビジネスがカバーする形でした。それは09
年度も続くと思われます。ソリューション/SIにおけるフィールド・イノベータの投入

によるビジネス拡大、SE の回転率向上等により 09 年度はサービス全体で増益を目指します。

Q. Sun 社が ORACLE 社に買収されることになりましたが、御社への影響についてどう考えればよろしいでしょうか。

A. (野副)

ORACLE 社と Sun 社のディールに関して当社からコメントすることは、両社に対してご迷惑になる可能性がありますので、原則控えさせていただきます。

日本市場における Sun 社のカスタマーベースは非常に巨大だと認識しております。お客様起点を重視する当社としては、ORACLE 社から今後も Solaris ライセンスを継続して供与していただけるよう、交渉してまいります。ORACLE 社とは 20 年来の協調関係にあります。今回、IA サーバをグローバルに 50 万台売るという計画を発表してから、数社から協業のオファーがありましたが、ORACLE 社もそのうちの 1 社です。ORACLE 社との新たな協業が進めば、それは当然 Sun 社も包含したものとなり、当社や当社の持つ Solaris ベースのお客様にとっても非常に有益なものになると考えます。私としては、ORACLE 社と Sun 社のディールが完了次第、すぐにでも協業の交渉に入りたいと考えております。

質問者 E

Q. 半導体等で減損処理していますが、繰延税金資産の取り崩しリスクについて教えてください。

A. (加藤)

半導体の減損については、TSMC との協業を行うという前提のもとに、09 年度の損益改善に向けてあえて当社の判断にて行ったものです。繰延税金資産の取り崩しについては、現時点問題とはなっていません。

HDD 事業の譲渡については今後損失がなくなるので、繰延税金資産に対しては、プラス要因となります。

Q. DE レシオが一時的に大きくなっているがについて教えてください。

A. 08 年度末時点では 1 倍を超えましたが、これは、今年度償還予定になっている SB、CB の 3000 億円に対して手当てを行ったためです。今後大きな資金調達を行う予定はありませんので、償還後の 6 月末には 0.6 程度には下がると思います。

質問者 F

Q: 半導体の売上高が 09 年度は前年度比 1000 億円の減収に対して、営業利益は改善していますが、その理由を教えてください。

A: (加藤)

半導体は、10 年度に黒字化するべく、体質改善を行っています。その中間地点が 09 年度になります。費用改善施策のうち、08 年度減損計上効果や先端プロセス関連の開発費用の圧縮、経費改善を含めて総額約 600 億円程度の改善効果になります。09 年度は売上が 1000 億円程度減少しますが、これらの効果により損益は改善します。

- Q: 財務キャッシュ・フローの 09 年度予測が▲1,600 億円という事から、3,000 億円の SB、CB 償還と 1,400 億円の新規借入れを行うという意味だと思いますが、D/E レシオの 0.6 倍というのは、あくまで期中のことであり、年度末ではないという理解でよろしいでしょうか？
- A: 設備投資について、業績を見ながらもう一段絞り込むということも念頭に置いていますので、フリーキャッシュフローについては、現時点の 600 億円からもう少し良くなる可能性があります。そうなれば、借入れも少なくなります。当社は下期偏重なので、それをリスクとして織り込んでいます。年度末には 1 倍以下、できれば 0.6～0.7 倍を目指したいと考えています。

以 上